



股票代號 7768

頌勝科技材料股份有限公司

2026元大證券第三季投資論壇

Precision | Vision | Innovation

引領CMP材料創新，打造全球競爭新優勢

2026.09.09



免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息，係本公司蒐集外部經濟發展現況並整合內部資料後所得，僅反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性，故實際營運結果、財務狀況以及業務展望可能與前瞻性資訊有所差異，其原因來自於各種公司所不能掌控的風險。
- 本公司對於前瞻性資訊不作任何聲明或保證，除非法令另有要求外，本公司亦不因新資訊、未來事件或其他情事變更事由，負有主動更新前瞻性資訊的義務。



CONTENTS

簡報大綱

01 | 公司簡介

02 | 財務表現

03 | 營運概況及未來展望



關於頌勝科技材料

● 成立時間

1986年

● 資本額

7億 65萬元

● 主要產品

半導體研磨墊與耗材 66%

醫療與運動產品 26%

綠色環保黏著劑、PU 彈性體 8%

● 員工人數

約 801人(統計日截至2025/12)

● 總部

臺中市西屯區工業區14路2號



CONTENTS

簡報大綱

01 | 公司簡介

02 | 財務表現

03 | 營運概況及未來展望



綜合損益表-2026Q2 vs 2025Q2 vs 2025年度

綜合損益表項目

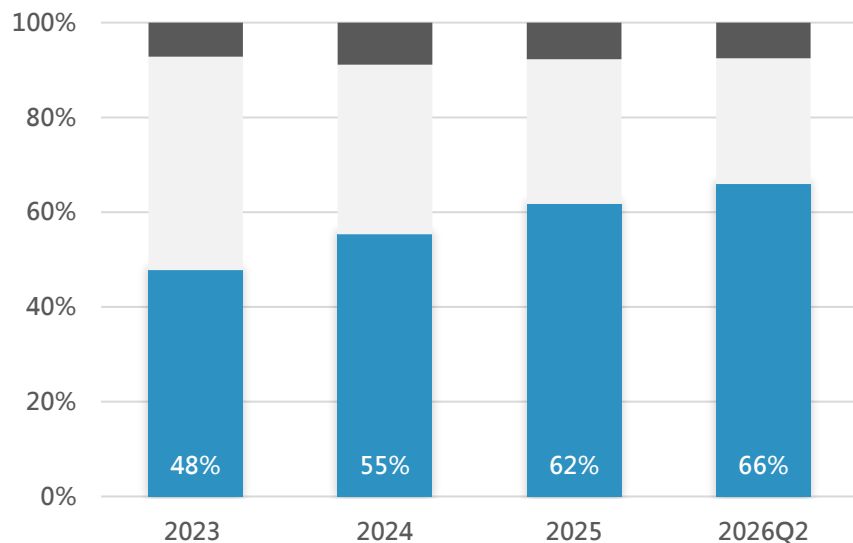
(除另予註明者外，金額以新台幣仟元)

	2026/1-6月	2025/1-6月	2025年度	年變化
營業收入淨額	1,129,571	1,018,796	1,980,776	+10.87%
營業毛利率	53.91%	50.45%	50.92%	+3.46%
營業費用	399,202	323,405	694,208	+23.44%
營業淨利	209,704	190,559	314,365	+10.05%
營業淨利率	18.56%	18.70%	15.87%	-0.14%
營業外收入及支出	81,646	(67,680)	(27,535)	+220.64%
歸屬予母公司業主之本期淨利	213,974	78,410	191,182	+172.89%
純益率	19.37%	8.17%	10.09%	+11.21%
每股盈餘(新台幣元)	3.32	1.35	3.24	1.97

經營績效

產品結構優化驅動毛利率持續上升

■ 半導體研磨墊與耗材
 ■ 醫療與運動產品
 ■ 環保黏著劑等



半導體產品營收占比變化

48% → 55% → 62% → 66%

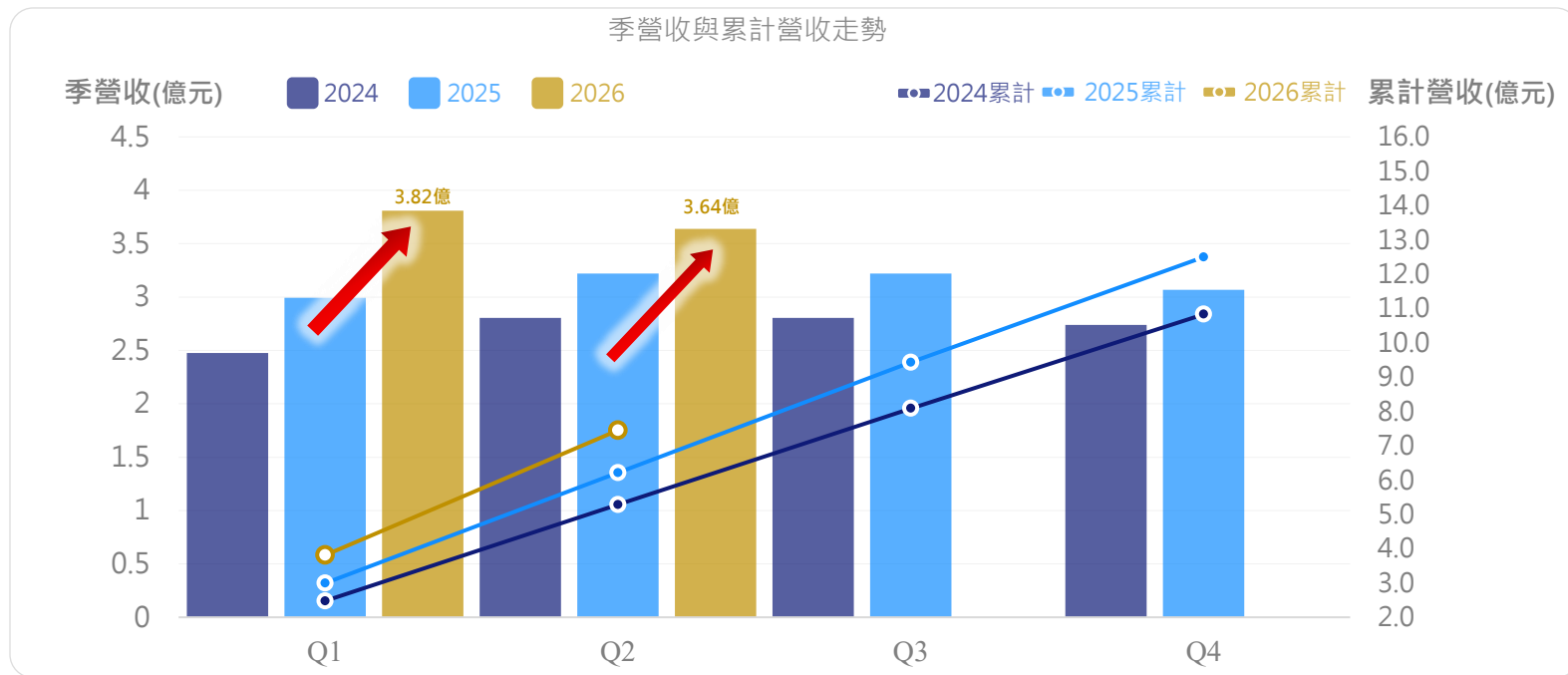
整體營業額成長動能

CAGR 25%

2023-2025營業複合成長率

經營績效

半導體業務趨勢：穩基礎、降波動、強成長



2024 – 2025：營收穩定，累計營收呈現穩定趨勢

2025：季節性效應低，營收波動變小，可預測性提升

2026：成長動能明確

經營績效

半導體業務：高基期穩成長，新動能再加速

2024 平均YoY

36%

高成長

2025 平均YoY

15%

穩延續

2026 平均YoY

25%

再加速

月營收(億元)

2024

2025

2026

YoY

1.5

1

0.5

0

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

70%

50%

30%

10%

-10%

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

- 連續三年平均維持雙位數成長
- 延續 2024 年 36% 的高基期，2025 年關稅變數下仍維持 15% 穩健成長
- 2026 年隨新動能發酵，下半年成長動能再度放大

半導體前10大客戶

2026H1			2026H1 vs 2025H1 金額百分比	2025H1		
排行	客戶名稱	%		排行	客戶名稱	%
1	Nxxxx	19%	112%	1	Nxxxx	21%
2	txxx	14%	170%	2	Sxx	11%
3	Sxx	10%	121%	3	Pxxx	10%
4	Pxxx	10%	117%	4	txxx	10%
5	Jxxxx	7%	97%	5	Jxxxx	9%
6	Uxx	4%	129%	6	SxxC	4%
7	SxxC	4%	112%	7	Pxx	4%
8	Pxx	4%	111%	8	Uxx	4%
9	Cxxx	3%	130%	9	Cxxx	3%
10	Fxxx	3%	*	10	Vxx	3%
	Others	23%	134%		Others	22%
		<u>100%</u>	125%			<u>100%</u>

* 2025下半年新增客戶，無比較基期

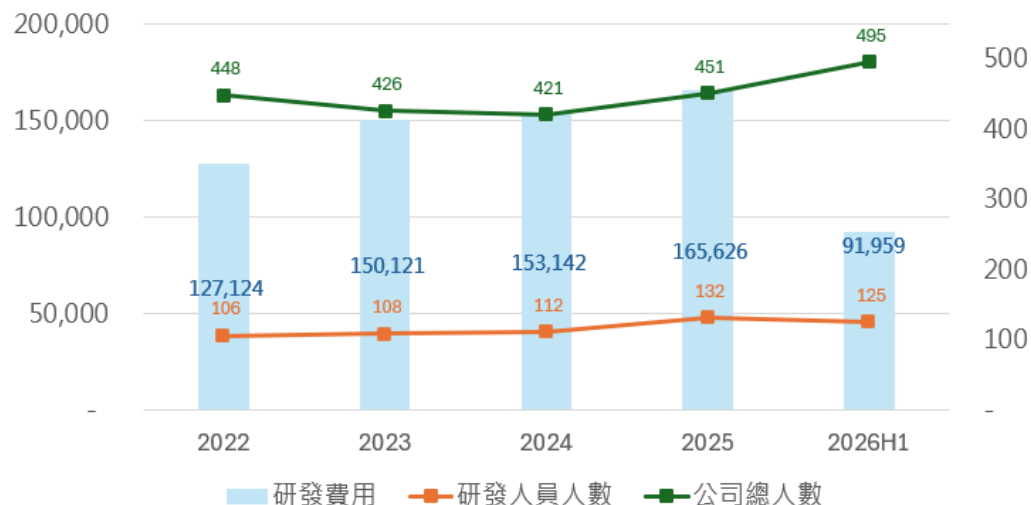
投入半導體研發資源(智勝子公司)



自2022年起半導體材料開發
累計研發費用投入**687,972**仟元

➤ 研發人員佔公司員工比例
25%

智勝歷年研發費用及研發人數表



單位：仟元

年度	2022	2023	2024	2025	2026H1
研發費用	127,124	150,121	153,142	165,626	91,959
研發人員人數	106	108	112	132	125
公司總人數	448	426	421	451	495

資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目
(新台幣仟元)

	2026/6/30		2025/6/30		年變化
	金額	%	金額	%	
現金及有價金融商品投資	3,210,788	46.56%	1,404,184	44.20%	+128.66%
應收帳款	383,721	5.56%	394,461	12.42%	-2.72%
存貨	451,692	6.55%	338,496	10.66%	+33.44%
不動產、廠房及設備	2,378,802	34.50%	714,016	22.48%	+233.16%
其他	470,628	6.83%	325,397	10.24%	+44.63%
資產總計	6,895,631	100.00%	3,176,554	100.00%	+117.08%
流動負債	1,256,381	18.22%	1,336,290	42.07%	-5.98%
長期負債	1,117,381	16.20%	178,994	5.63%	+524.26%
負債總計	2,373,762	34.42%	1,515,284	47.70%	+56.65%
股東權益總計	4,521,869	65.58%	1,661,270	52.30%	+172.19%
重要財務指標					
流動比率(倍)	3.30		1.61		+105.28%
負債比率	34.42%		47.70%		-27.84%
平均收現日數	113.55		124.34		-8.68%

股利政策

2023-2025年度股利發放政策

年度	加權平均流通在 外股數(仟股)	EPS	現金股利	資本公積發 放現金	合計
2025	70,065	3.24	2.455	1.045	3.5
2024	60,000	4.42	3.45	-	3.45
2023	51,992	0.90	0.59	1.41	2.0

近三年股利維持穩定配發，最低配發率78%



CONTENTS

簡報大綱

01 | 公司簡介

02 | 財務表現

03 | 營運概況及未來展望



AI時代，CMP從製程環節走向關鍵材料

Advanced Logic
GAA / Backside Power



Advanced Packaging
Chiplet / 2.5D / 3D



AI / HPC



More Layers
More Complexity

Advanced Memory
HBM



Hybrid Bonding
Cu-to-Cu / Dielectric



More Layers
更多層次



Higher Planarity
更高平坦度



More CMP Steps
更多CMP Steps



Tighter Defect Control
更嚴格Defect Control

製程越先進、結構越複雜，CMP的重要性與使用次數越高



股票代號 7768

AI時代，CMP從製程環節走向關鍵材料

AI驅動新架構與異質整合，推升製程複雜度、CMP使用次數與材料規格要求

更多層次 × 更高平坦度 × 更多CMP Steps × 更嚴格Defect Control



AI不是直接帶來CMP成長，而是透過新架構與異質整合，讓平坦化成為更多關鍵製程的必要條件。

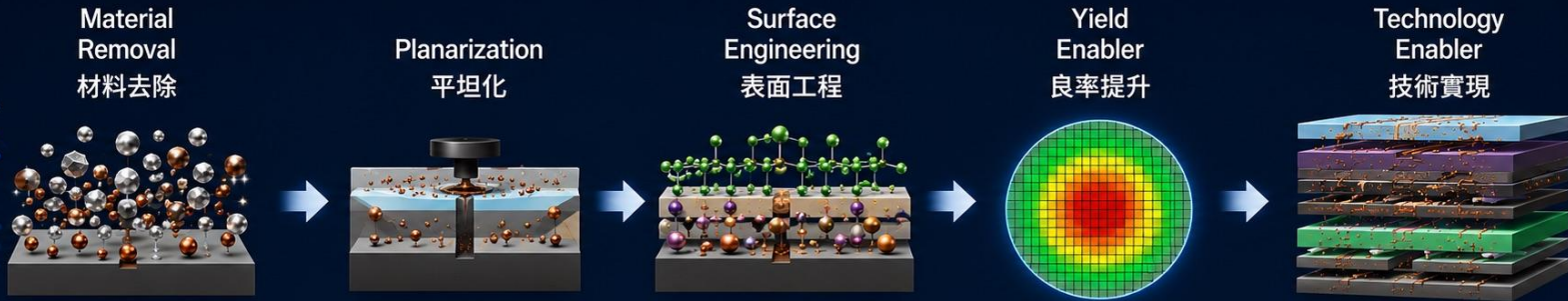
「製程越先進、結構越複雜，CMP的重要性與使用次數越高。」

CMP Importance & Value ↑



股票代號 7768

CMP的角色正在改變



Planarity
平坦度

×

Defect
缺陷

×

Selectivity
選擇比

→

Surface Quality
表面品質

→

Yield
良率

**CMP的價值，已經不只是把材料磨掉，
而是創造下一層製程所需要的精密表面。**



股票代號 7768

CMP精密平坦化的應用版圖正在擴大

Advanced Logic
GAA / BEOL /
Backside Power



Advanced Memory
/ HBM
DRAM / NAND /
TSV / Stacking



Advanced Packaging
Chiplet / RDL /
2.5D / 3D



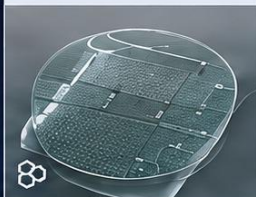
Hybrid Bonding /
Interposer
Cu-to-Cu /
Dielectric /
Interposer



Wafer
Manufacturing
長晶/晶圓加工/
Wafer Polishing



Glass & New
Materials
Glass Interposer /
Next-gen Materials



CMP與精密平坦化的應用，正從傳統前段製程，
先進延伸到先進封裝、晶圓、玻璃、中介層以及下一代材料



股票代號 7768

CMP研磨與平坦化的應用版圖持續擴大

從先進邏輯、記憶體與封裝，延伸至晶圓、玻璃、中介層與下一世代材料



Advanced Logic

GAA / BEOL
Backside Power



Advanced Memory / HBM

DRAM / 3D NAND
TSV / Stacking



Advanced Packaging

Chiplet / RDL
2.5D / 3D



Hybrid Bonding / Interposer

Cu-to-Cu / Dielectric
中介層研磨



Wafer Manufacturing

長晶廠晶圓研磨
Wafer Polishing



Glass & Next-generation Materials

玻璃研磨 / Glass Interposer
新材料研磨

面對的不是單一CMP市場，而是一個持續擴張的「精密平坦化」應用版圖。

Advanced Semiconductor → Advanced Packaging → Wafer / Glass / Interposer → Next-generation Materials



股票代號 7768

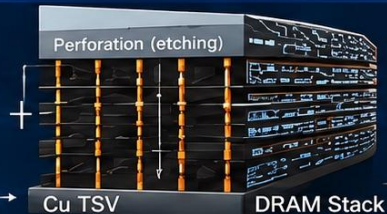
下一代技術正在提高CMP材料價值

GAA / Advanced Logic



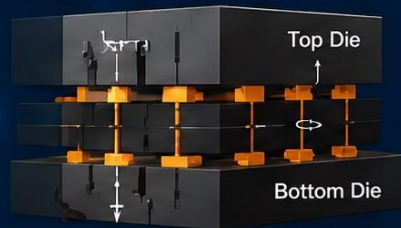
- 多層互連 (More Interconnects)
- 平坦度 (Planarity)
- 選擇比 (Selectivity)
- 低缺陷 (Low Defect)

HBM / TSV



- DRAM Stack 平坦度
- TSV CMP
- Bonding Interface
- Coplanarity

Hybrid Bonding



- Cu-to-Cu / Dielectric Bonding
- Nanometer-level Planarity
- Surface Quality

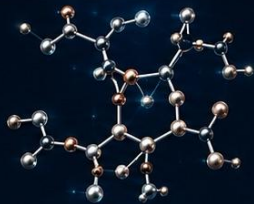
CMP的價值不只在材料去除，更在於建立下一層製程所需要的精密平坦表面，直接影響製程窗口，缺陷與良率。



股票代號 7768

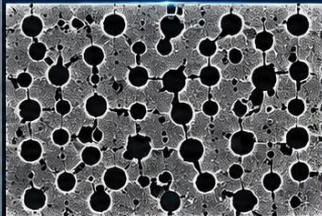
AI時代，材料創新是下一世代CMP的核心

Material Design 材料設計



- Polymer Design
- Hardness Control
- Porosity Control

Pad Structure 結構設計



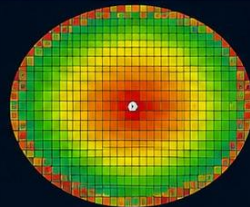
- Pore Structure
- Groove Design
- Surface Topography

CMP Performance 性能表現



- Removal Rate (RR)
- W/WNU
- Defect Density
- Selectivity

Process & Yield 製程與良率



- Process Window
- Stability
- Yield Improvement

材料決定極限，設備決定上限。

真實高剛的CMP，需要理解 Pad × Slurry × Conditioner × Equipment × Process 之間的交互作用。



股票代號 7768

核心技術與競爭優勢

CMP為先進製造的核心賦能技術



混合鍵結 (hybrid Bonding)

3D IC與先進封裝要求奈米級的完美鍵合介面，使CMP應用大幅增加



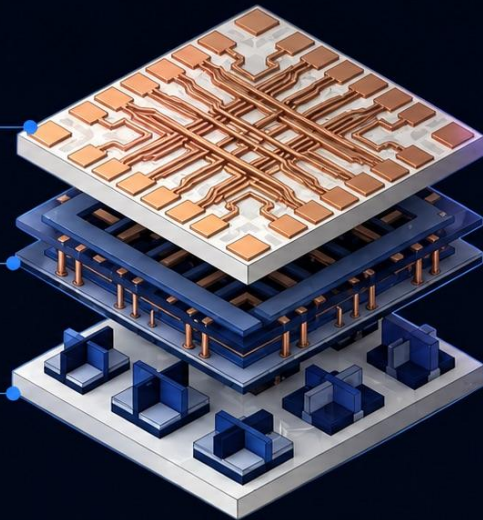
供電網路革命 (BSPDN)

晶背供電技術的實現，完全依賴CMP作為無缺陷佈線的關鍵前置條件



先進電晶體架構

CMP的平坦化精度，直接決定先進架構 (FinFET、GAAFET) 的最終電性與元件性能



CMP不再是只能「被動磨平」，而是直接決定元件性能與結構可行性的關鍵技術



股票代號 7768

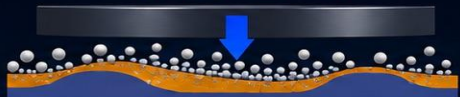
核心技術與競爭優勢

化學機械平坦化 (CMP) 的三階段解析



1 快速整平 第一盤

快速去除大量過剩材料
實現初步大範圍平坦化



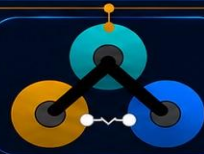
2 精準研磨 第二盤

精確控制材料去除量
實現優異的局部平坦化



3 精拋清潔 第三盤

去除前兩階段的微小缺陷
提供最終鏡面光潔度



CMP Tool Configuration 示意圖



鑽石碟
修整研磨墊
維持平坦度



研磨墊
提供支撐力
與接觸性能



研磨液
化學作用與
潤滑冷卻

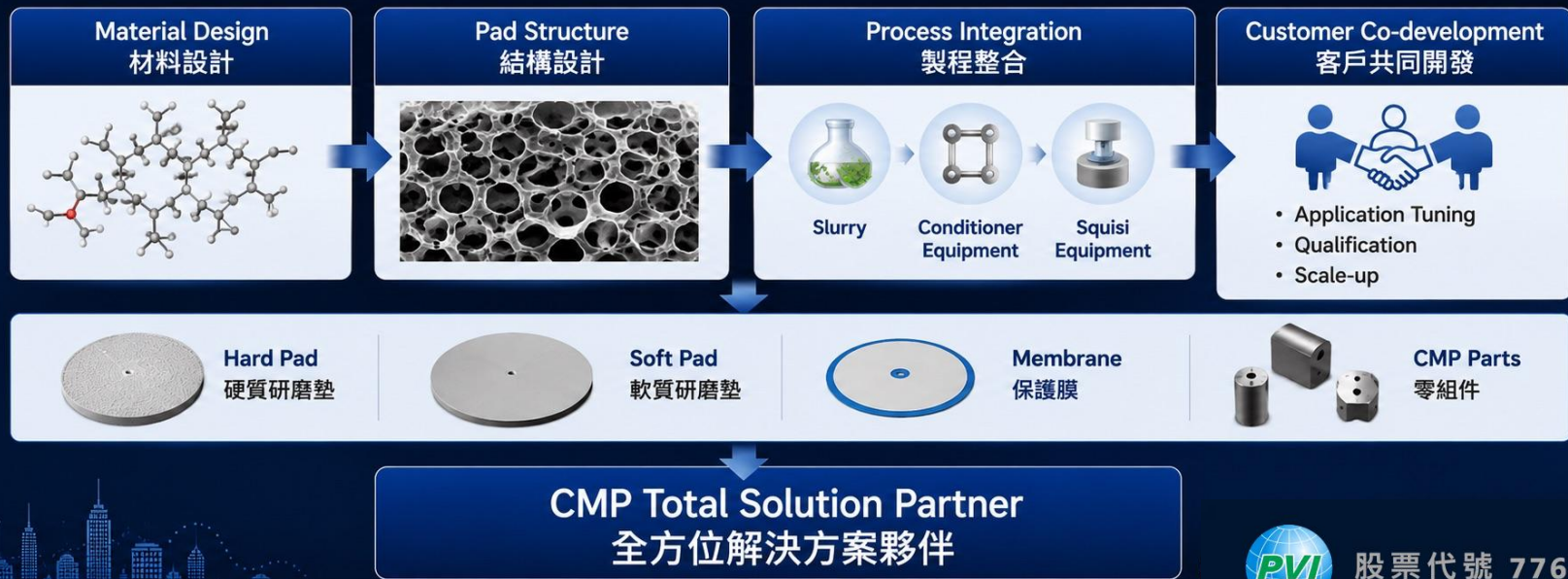


硅膠薄膜
精準控制壓力
實現均勻接觸



股票代號 7768

From Pad Supplier to CMP Solution Partner



股票代號 7768

從材料供應商走向「共同定義下一世代製程」

異質整合與新架構快速發展，材料商的角色正從「符合既有規格」走向「與客戶共同制定新規格」

過去 | Moore's Law Scaling



製程微縮



相對明確的材料規格



Material Supplier

Beyond
Moore's Law



現在與未來 | Heterogeneous Integration

GAA • HBM • Chiplet • Hybrid Bonding



新的材料

×



新的結構

×



新的製程

客戶需要的不只是「符合規格的材料」

Co-define New Specifications × Co-develop New Processes

CMP Total Solution Partner

「當下一世代製程尚未有既定答案，材料供應商的價值，
就從『符合規格』走向『與客戶共同定義規格』。」

Material Supplier → Technology Co-development → CMP Total Solution Partner



股票代號 7768

為什麼是頌勝科技？40多年累積的材料、配方、製程技術核心能力

40+ Years of Material, Formulation & Process Technology Expertise

從原料、配方、產品、製程到應用，關鍵技術自主掌握



40+ Years Technology DNA



「40多年累積的不只是製造經驗，而是從材料、配方、產品設計、製程技術到客戶應用的完整技術 **Know-how**。」



股票代號 7768

核心技術與競爭優勢

為何化學機械平坦化 (CMP) 很難有新進者？



研磨墊具有三重護城河，
競爭者難以複製



高度客製 | 客戶驗證

深入客戶合作調教
認證週期長且替換成本高



專利圍牆

核心技術受專利保護
競爭者難以合法複製



原料的掌控

自研且多元的配方組合



股票代號 7768

核心技術與競爭優勢

CMP已從製程配角成為決勝關鍵

	過去	現在	未來
核心功能	Supporting Process (配角)	Enabling Technology (關鍵技術)	Yield & Integration Driver (決勝製程)
技術焦點	單一層面的厚度控制 各屬堆疊層間的過渡步驟	決定奈米級結構精度 新穎材料整合	先進封裝 異質整合 晶背供電 良率的最終守門員
商業價值	標準化 耗材供應	具備高度 技術壁壘與定製化需求	決定最終良率 與客戶深度合作 長期策略綁定 具備高ASP潛力

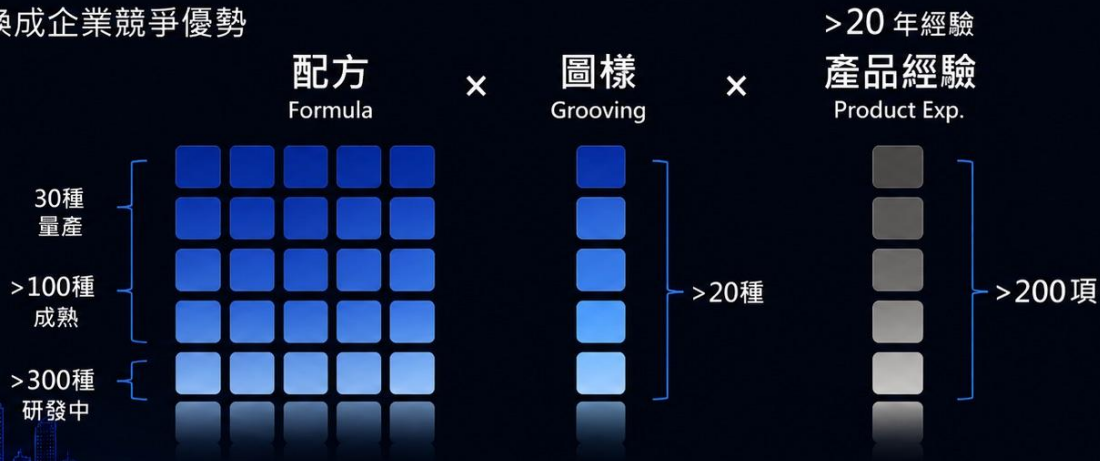
誰能夠替客戶解決未來的問題客製化 就是最後的贏家



股票代號 7768

核心技術與競爭優勢

多年的經驗轉換成企業競爭優勢



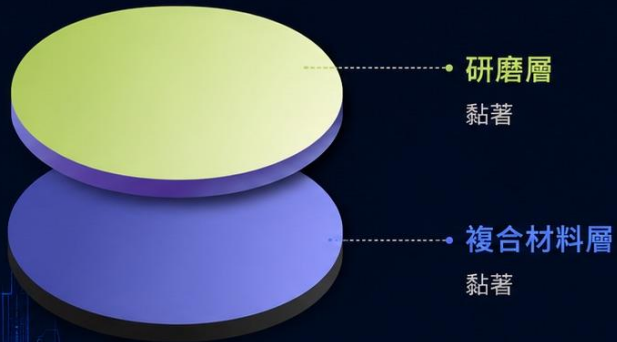
誰能夠替客戶解決未來的問題客製化 就是最後的贏家



股票代號 7768

核心技術與競爭優勢

獨特核心技術



01 原料設計 | 單片式無毒空氣發泡



02 溝槽設計



03 複合材料堆疊設計



股票代號 7768

核心技術與競爭優勢

獨特**核心技術**

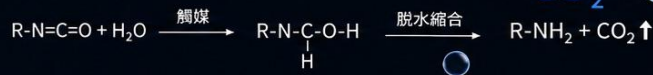
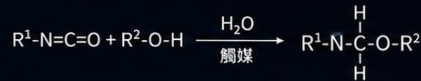


研磨層
黏著

複合材料層
黏著



01 原料設計 | 單片式無毒空氣發泡



CO₂



02 溝槽設計



Air Cell



03 複合材料堆疊設計



自研原料配方



無毒發泡



高品質穩定



孔隙可調



依客戶客製



股票代號 7768

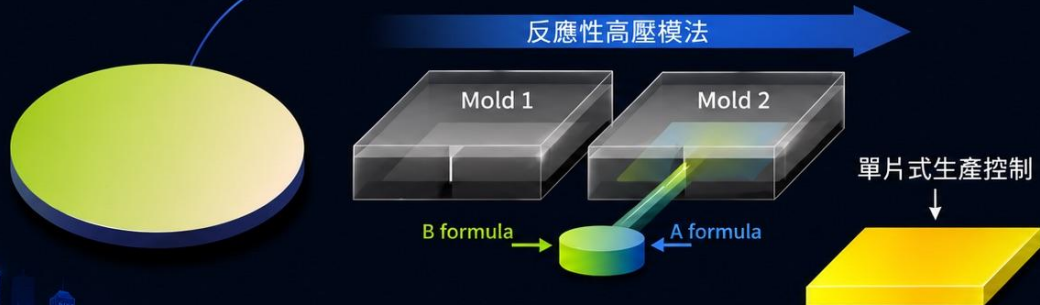
核心技術與競爭優勢

獨特**核心技術**

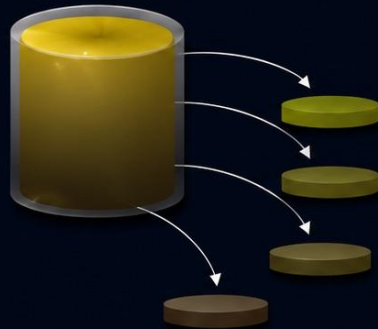


01 原料設計 | 單片式無毒空氣發泡

反應性高壓模法



傳統的灌注技術
(非本公司之技術)



自研原料配方



無毒發泡



高品質穩定



孔隙可調



依客戶客製



股票代號 7768

核心技術與競爭優勢

獨特核心技術



02 溝槽設計

Perforation



穿孔型
快速排液
防堵塞

Concentric



同心圓型
均勻研磨
穩定拋光

Spiral



螺旋型
強化排液
降低熱累積

Complementary



互補型
雙向排液
提高效率

Radial



放射型
集中受力
提升平坦度

XY grid



XY 網格型
均衡支撐
提升結構強度

流場模擬 | 客製多元溝槽設計 | 降低客戶研磨液使用量



流場模擬



客製多元溝槽設計



降低客戶
研磨液使用量



提升研磨效率
與品質穩定性



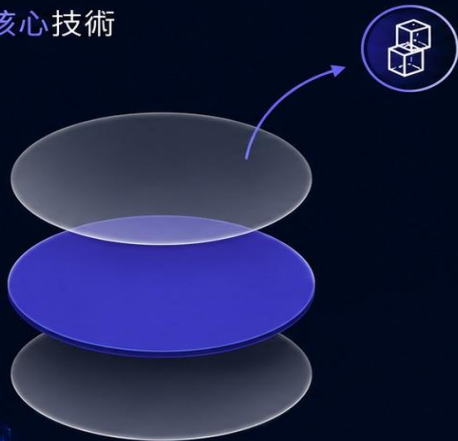
延長拋光墊
使用壽命



股票代號 7768

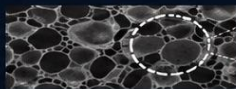
核心技術與競爭優勢

獨特核心技術

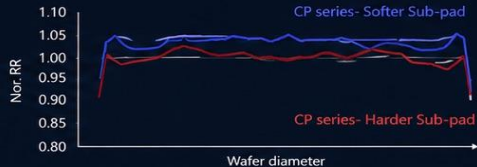


03 複合材料堆疊設計

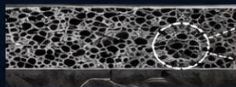
CP Sub Pad 複合層 (Closed Pore)



Hard rigidity due to closed pore structure



OP Sub Pad 複合層 (Opened Pore)



Softer rigidity due to opened pore structure



降低研磨應力 | 減少晶圓研磨缺陷 | 增進研磨均勻性 | 達成客戶多面向之要求



流場模擬



客製多元溝槽設計



降低客戶
研磨液使用量



提升研磨效率
與品質穩定性



延長拋光墊
使用壽命



股票代號 7768

核心技術與競爭優勢

五大專利佈局堆疊形成之技術壁壘

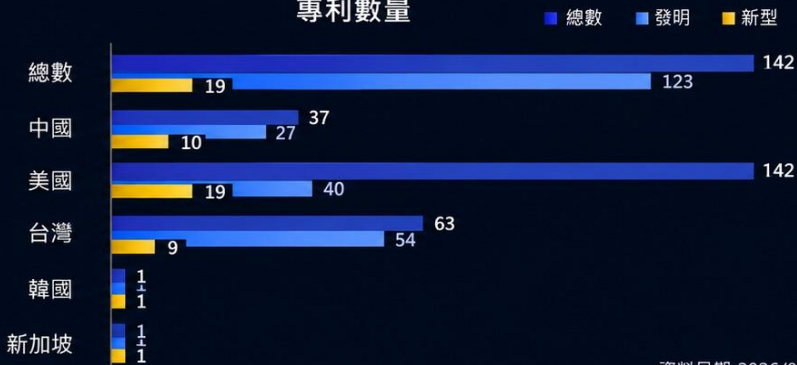


股票代號 7768

專利類型



專利數量



資料日期 2026/02

二十年技術淬鍊，累積更多企業最關鍵的營業秘密



更多轉化
營業秘密



累積企業
關鍵技術



打造競爭優勢
提升市場門檻



穩固技術壁壘
強化競爭護城河



長期優勢
永續成長



股票代號 7768

智勝產品發展史

20+ Years of
Technology & Market Evolution

從第一張訂單，到下一世代 CMP——20多年持續累積技術、產品與市場深度。

第一個 5 年

01



建立基礎

2002 - 2006

- 2003年 - 通過 ISO 9001 認證
- 2003年 - 獲第一張 12吋研磨墊訂單 P公司
- 2005年 - 獲 12吋彈性薄膜第一張訂單 P公司

2002 成立

第二個 5 年

02



邏輯 IC 市場

2007 - 2011

- 2003年 - 獲 U公司 8吋研磨墊第一張訂單 (晶圓廠)
- 2009年 - 與美國 D 公司專利訴訟，勝訴
- 2009年 - 獲 t公司 再生晶圓應用訂單
- 2010年 - 獲研磨墊海外市場第一張訂單 CSMC
- 2011年 - 獲 U公司 12吋箔訂單
- 2011年 - 獲得新加坡 S公司 研磨墊多道製程訂單

第三個 5 年

03



擴展海外市場

2012 - 2016

- 2013年 - 獲彈性薄膜海外市場第一張訂單 UMCi
- 2013年 - 取得 t公司 CoWoS 訂單
- 2015年 - 取得 t公司 roller 訂單

第四個 5 年

04



中國市場

2017 - 2021

- 2017年 - 成立 蘇州觀勝
- 2019年 - 獲 歐美市場第一張研磨墊訂單
- 2019年 - 獲 I公司 彈性薄膜訂單
- 2021年 - 獲 M公司 研磨墊訂單

2023年 - 取得 t公司 SoIC 訂單

第五個 5 年

05



高階應用

2022 - 2026+

歷年累計量產產品數量

Cumulative Number of Products Successfully Mass-Produced By Year



技術深耕 · 持續創新 · 拓展全球市場

我們不只是台灣唯一，更希望成為全球 CMP 研磨材料的領導廠商



股票代號 7768

市場機會

洞悉市場關鍵機會：研磨拋光全鏈應用



市場機會

深耕先進關程與封裝應用

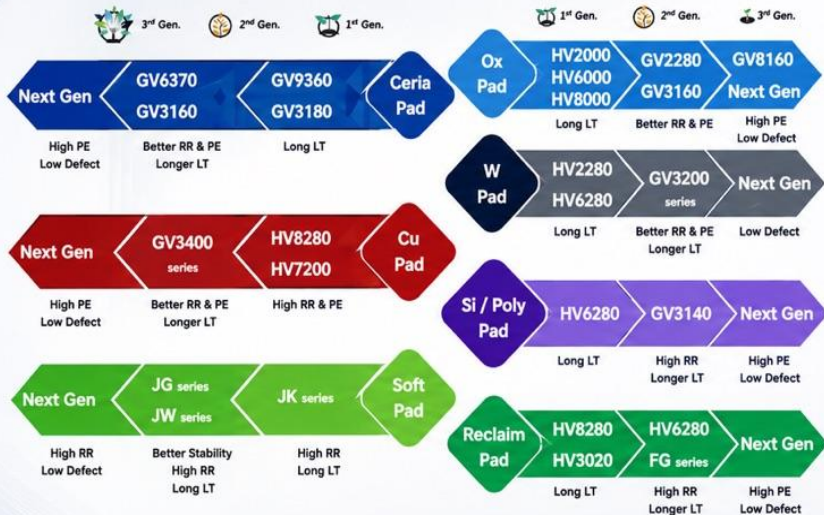
應用別		產品項目	銷售占比	代表客戶例
上游	再生晶圓 / 晶圓基板	軟質 / 硬質 研磨墊 12吋 / 大尺寸	6.91%	    
中游	邏輯 / 記憶體 製造	軟質 / 硬質 研磨墊 8吋 / 12吋	90.20%	               
下游	先進封裝	軟質 / 硬質 研磨墊 12吋	2.89%	 



股票代號 7768

產品開發與應用時實踐

iVT Pad Product for Application



市場機會與策略

量產品穩定成長，研發數持續開案

件數

430

資料日期：2026/6

380

280

180

130

130

80

30

-20



■ 新開專案

■ 研發中專案

■ 量產品



新開專案

8.2%

55件



研發中專案

60.2%

403件



量產品

31.6%

212件

重點

- 量產品穩定增長
- 研發專案合作案持續轉量產
- 訂單逐步放大，提升營收



股票代號 7768

頌勝科技如何把40多年Know-how轉化為CMP解決方案

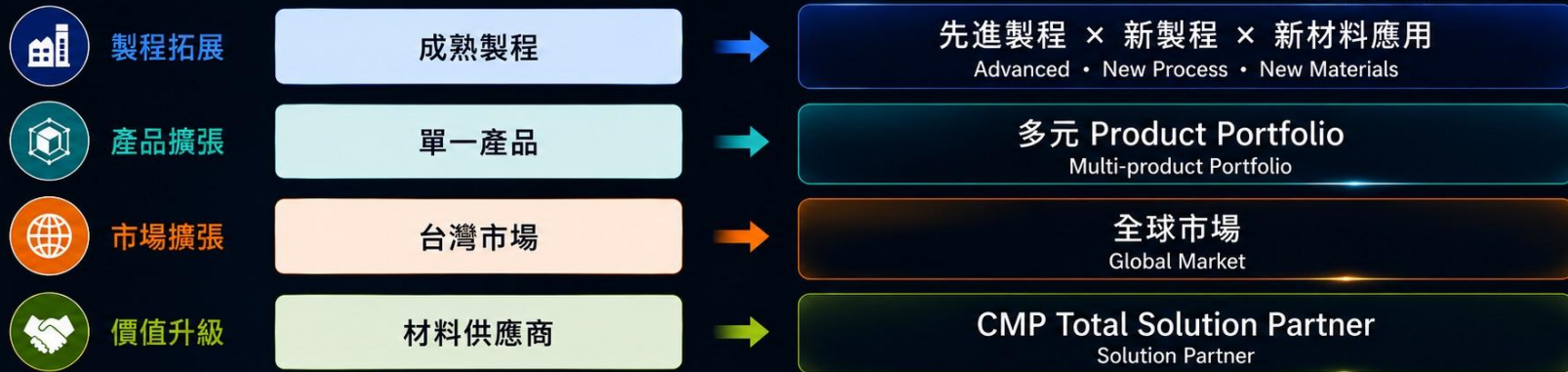


40+ Years Know-how → Integrated Technology Capability → Customer Value



股票代號 7768

智勝科技下一階段成長藍圖



40+ Years Know-how



New Process & Product Expansion



Customer Co-development



Global Growth



AI與異質整合推動CMP走向更多新製程、新材料與高階應用。

憑藉40多年材料、配方與製程技術，智勝科技將與客戶共同開發、從台灣走向全球，掌握長期成長機會。



股票代號 7768

市場機會與策略

多層策略堆疊



ASP 平均銷售單價



搶佔未來技術的制高點

先進製程驅動價值躍升

鞏固基石與橫向發展



前瞻新技術

實現一開始就進入的紅利，搶佔先機



先進製程

與頂尖客戶進行深度合作開發，提升產品ASP



先進封裝

已有產品正式量產
晶背供電 | 共同封裝光學 (CPO) | TGV



既有產品 - 橫向展開到新應用

將成熟產品導入全新應用領域
化合物半導體 | 散熱基板 | 矽光子 (SiPh)



既有產品 - 受惠於地緣政治供應鏈重組

受惠於「地緣政治」帶來的供應鏈重組



股票代號 7768

從單一Pad走向多元CMP Product Portfolio

產品線從研磨墊延伸至Membrane與CMP Parts，並對應**更多材料與精密研磨應用**



Hard Pad

高平坦度
High Planarity



Soft Pad

低缺陷 / 表面控制
Low Defect



Membrane

壓力與均勻性控制
Pressure / Uniformity



CMP Parts

製程耗材與零組件
Process Support



Application & Material Platform



Cu



Oxide



W



Barrier



新材料 CMP



Wafer



Glass



Interposer

Single Product → Multi-product Portfolio → Higher Customer Value

擴大產品組合 × 擴大應用範圍 × 提升客戶服務深度



股票代號 7768

市場機會與策略

CMP Pad 標準研磨墊方案



成熟製程

成熟製程研磨墊

穩定供應

成本優勢



先進製程

先進製程研磨墊

高平坦化

低缺陷

高選擇比



先進封裝
CoWoS

封裝製程研磨墊

高均勻性

大面積研磨

Joint Development 客製化方案

製程優化服務

在地支援

良率提升

與客戶共同開發

配方設計

產品設計

驗證導入



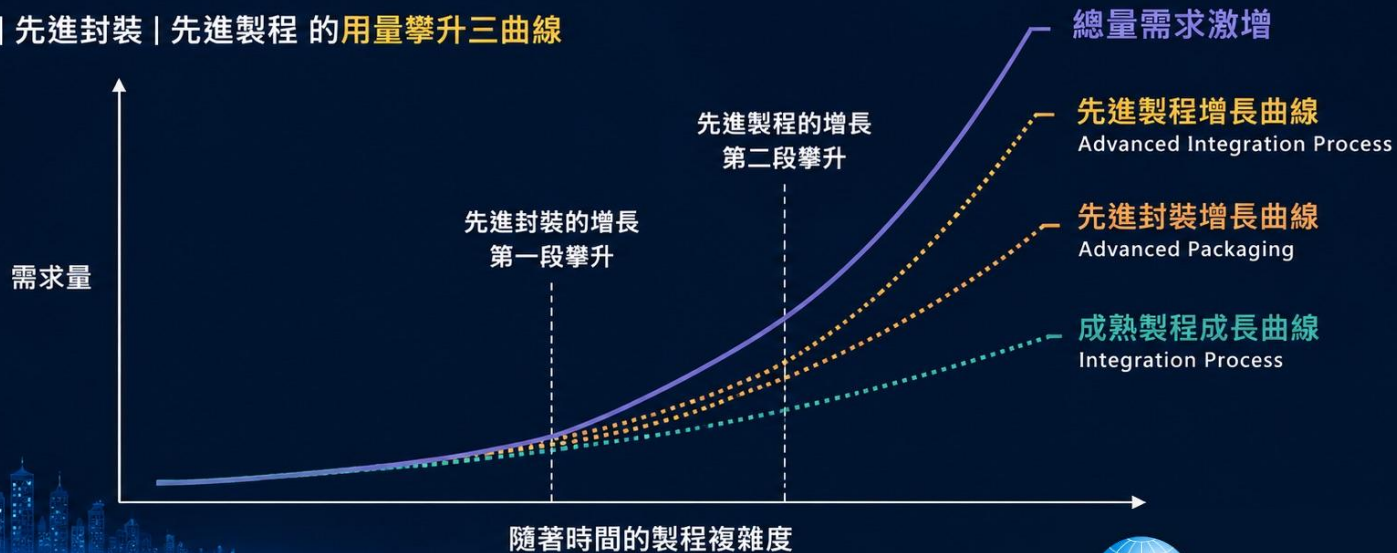
以**創新研磨技術**與**客製化**解決方案，協助客戶提升製程效能，創造長期合作價值



股票代號 7768

市場機會與策略

成熟製程 | 先進封裝 | 先進製程 的用量攀升三曲線



股票代號 7768

提前布局產能、研發與自動化，準備承接全球成長

因應未來布局與產能需求，碩勝科技積極擴建工廠及研發中心，投入新設備並導入自動化



智勝科技已提前為下一階段成長布局與投資



「擴產不只是增加產能，更是同步提升品質、製程穩定度、交付能力與全球客戶服務能力。」

Capacity & Capability Expansion ➡ Integrated Growth Investment ➡ Global Customer Value



股票代號 7768

Innovation Requires Long-Term Commitment

R&D 研發創新



- 材料研發
- 產品創新
- 應用開發

Manufacturing 製造能力



- 產能擴充
- 製程優化
- 品質一致性

Automation 智慧製造



- 自動化設備
- 數據化管理
- 製程監控

Quality 品質保證



- 品質系統
- 可靠性驗證
- 持續改善

Global Service 全球服務



- 全球據點
- 在地技術支援
- 快速服務

Innovation is not a project. It is a long-term commitment.

創新不是一個專案，而是一項長期的承諾。



股票代號 7768

From Taiwan to the World | 從台灣走向全球

Taiwan

技術 / 研發 / 製造基地

Technology • R&D • Manufacturing



Asia

貼近客戶 / 區域服務

Customer Proximity • Regional Service



Global Market

全球客戶 / 全球供應

Global Customers • Global Supply



全球化的四個基礎



Technology

材料 / 配方 / 製程技術



Products

多元產品組合



Capacity

產能 / 品質 / 自動化



Customer Co-development

共同開發 / 技術服務

Local Technology Foundation → Global Customer Value

“ 以台灣建立的**核心能力**為起點，逐步擴大全球客戶、全球技術服務與全球供應能力。 ”



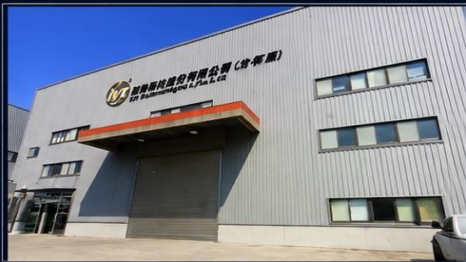
股票代號 7768

營運據點：研發中心(台中二廠)



股票代號 7768

營運據點：矽膠薄膜 (台中三廠)



固態熱壓製程：
高客製化、配方調配彈性優勢



MM表面處理裝置



液態射出製程：
高產出、成本優勢



股票代號 7768

營運據點: Soft pad 產線



固態熱壓製程:
高客製化、配方調配彈性優勢



MM表面處理裝置

液態射出製程:
高產出、成本優勢



股票代號 7768

營運據點：China工廠



張家港工廠

Zhangjiagang Factory



合肥新廠

Hefei New Factory



股票代號 7768



观胜半导体科技(合肥)有限公司
IV Technologies (Hefei)co.,Ltd.



股票代码 7768

观芯筑基立合肥·胜材创新耀未来

2026

观胜半导体科技（合肥）有限公司

开业盛典



CHINA

合肥

2026.06.17



股票代码 7768

營運據點: soft pad 基布製造廠 (台中四廠)



營運據點：全球營運總部 (中科新廠)



1F 大廳



1F 接待區



iVT 1.0

高築牆

建立核心優勢，構築堅實競爭壁壘

從原料掌握到客戶應用，全部自主掌握的一條龍服務

原料掌握



關鍵掌握
自主開發關鍵體

配方研發



獨家配方設計
材料科學優化

產品設計



Pad 結構設計
孔洞/溝槽/表面

製程開發



製程整合開發
參數最佳化

客戶應用



客製化調整
應用最佳支援

完整一條龍服務，創造高效價值



擴大核心技術優勢

高分子材料、孔洞結構、表面處理、配方設計、製程整合等關鍵技術深耕，持續創新突破。



鞏固核心技術團隊

培育與留任關鍵人才，打造技術傳承與創新文化。



專利策略布局

全球專利布局，建立專利護城河，確保技術領先優勢。



製程成本控制

優化製造流程與供應鏈管理，提升材料利用率與良率，創造成本優勢。



技術為本 · 品質為盾 · 效率為競爭力

廣積糧

擴大布局，厚植實力，準備迎向成長

01



布局亞洲市場

以台灣為核心，深耕中國大陸，逐步拓展亞洲主要半導體市場，貼近客戶需求。



02



結盟合作夥伴

與設備、Slurry、材料及產業鏈夥伴建立策略合作，形成CMP生態系，共同開發市場。



03



擴大產品應用領域

從既有CMP應用延伸至先進邏輯、HBM、先進封裝、面板研磨及新材料等領域。



04



擴大客戶基礎

深化策略客戶合作，增加產品驗證與量產導入，持續擴大市場占有率。



05



建立量產能力，準備充足產能

建置智慧量產及自動化能力，提升品質一致性與交付能力，為未來市場成長做好準備。



06



增加優秀團隊與研發人才

持續延攬研發、製造及應用人才，強化組織與創新能力。



07



建立研發中心，與客戶共同開發

建立研發與應用平台，與客戶共同解決下一代CMP技術問題。



布局亞洲 · 結盟夥伴 · 擴大應用 · 厚植量產實力

iVT 3.0

緩稱王

引領技術未來，成為全球領導者

iVT 智勝科技股份有限公司
iVT Technologies Co., Ltd.

掌握下一世代技術・CMP 成為關鍵製程技術

新世代技術版圖・CMP 關鍵角色

先進邏輯 2nm ~ 14nm GAA / FinFET	晶背供電 Backside Power BSPDN / Hybrid Bonding	先進封裝 2.5D / 3D IC Chiplet / SiP	先進記憶體 HBM / DRAM 3D NAND
異質整合 Chiplet / SiP Multi-material Integration	Hybrid Bonding Cu-to-Cu / Dielectric Bonding	晶圓方形化 Round Wafer ~ Square Substrate / Panel	新材料與基板 Glass / Glass Interposer / New Materials



擴大核心技術優勢

高分子材料、孔洞結構、表面處理、配方設計、製程整合等關鍵技術深耕，持續創新突破。



鞏固核心技術團隊

培育與留任關鍵人才，打造技術傳承與創新文化。



專利策略布局

全球專利布局，建立專利護城河，確保技術領先優勢。



製程成本控制

優化製造流程與供應鏈管理，提升材料利用率與良率，創造成本優勢。

iVT 3.0 策略重點



更高階研發中心，協助客戶開發下一世代CMP

打造世界級研發能量，與客戶共同解決新技術挑戰，引領產業創新。



20+年技術累積與品質掌握

深厚的材料、配方、製程、品質與客製化能力，提供最可靠的CMP解決方案。



新廠設備導入自動化生產與智慧製程 管理並導入 AI

中科新廠（台灣）與大陸新廠導入自動化設備，智慧製造與數據管理，AI驅動品質與效率升級。



中科新廠（台灣）



大陸新廠



全球化布局完成，成為全球CMP研磨墊材料領導公司

全球布局，在地服務，貼近客戶，以創新、品質與服務，成為全球CMP研磨墊材料領導者。



技術領先・全球布局・成為產業領導者

iVT's Thinking

思維：藍海市場



核心能力做到極致



最喜歡挑戰高難度市場。



重視研發，但售價需大於成本4倍以上才有研發意義。



不怕客戶要求高，就怕客戶不要求。



重視客戶需求，願為客戶量身打造客戶專屬產品。



有策略的發展核心技術，建立技術障礙。



不以現況為滿足，不斷思考開發下一個未來產品。

攀過高峰，您會看見世界更寬廣、美好

Together, We Shape the Future of CMP



面對下一世代半導體製程，我們攜手合作、共同創新，
從材料、設備到製程，一起設定目標、同步啟程、終點會合。



股票代號 7768

KEY TAKEAWAYS

從材料創新，走向下一世代 CMP

從技術扎根到全球布局，驅動創新與成長，成為全球 CMP 關鍵材料與製程技術的領導者

01



CMP 的角色正在改變

從 Supporting Process 走向 Enabling Technology

02



技術深度決定競爭門檻

材料 × 配方 × 結構 × 製程 × 應用
形成難以複製的 Technology Barrier

03



客製化能力成為關鍵競爭力

不只是提供產品
而是與客戶共同解決下一世代製程問題

04



下一世代半導體，帶來更大的 CMP 機會

製程越先進、結構越複雜
CMP 的重要性與使用次數越高

05



我們不只是台灣唯一，
更希望成為全球 CMP 研磨材料的領導廠商



我們不只做 CMP 材料，更希望成為客戶下一世代製程的共同開發夥伴。

NEXT-GENERATION

CMP

引領技術未來
成為全球領導者



Advanced Logic



HBM



Advanced Packaging



Hybrid Bonding



Backside Power



New Materials



股票代號 7768



Q&A

感謝您的聆聽

